

我省这条交通“主动脉”计划月底通车

合徐南改扩建项目北接蚌埠 串联定远、凤阳、肥东等地 南连合肥

本报讯(安徽商报记者 姜志远)5月5日,安徽商报记者从安徽交控集团获悉,备受关注的合徐南改扩建项目计划本月底全面通车。与此同时,宁旌高速(安吉至旌德高速公路宁国至旌德段)建设已进入冲刺阶段,预计10月底建成并具备通车条件。

据悉,合徐南改扩建项目是我省连接南北的交通“主动脉”,北接蚌埠,串联定远、凤阳、肥东等沿线重要城镇,南连合肥,长期以来承担着繁重的交通通行任务。该项目全长约107公里,起自蚌埠互通,止于肥东县境内京台高速与合肥绕城高速交汇的路口枢纽互通,全线采用双向八车道高速公路标准建设,设计时速120公里。目前,该项目合肥往蚌埠方向单幅已率先建成通车,整个项目计划今年5月底全面通车。

宁旌高速(安吉至旌德高速公路宁国至旌德段)项



目起于宁国市境内胡乐镇胡乐村,设胡乐枢纽与G4012溧宁高速衔接,路线向西经俞村镇、旌阳镇,终于蔡家桥镇接入S11巢黄高速。该路线总体呈东西走向,穿越宣城市的宁国市、旌德县,主线里程约32公里,采用双向四车道设计标准,设计速度100公里/小时,路基宽度26米,设桥梁23座、隧道2座(梅村隧道、新岭脚隧道)、枢纽互通2处(胡乐互通、旌德互通)、服务型互通2处(旌德北互通、蔡家桥互通)、服务区1处(俞村服务区)、收费站2处(旌德收费站、旌德北收费站)。

截至目前,该项目路基土石方、桥梁、隧道工程全部完工,附属工程同步推进。按照计划,该项目预计10月底提前建成通车。整个项目建成后,将改善宁国南部区域及旌德对外交通联系,缓解同走廊国道G330交通压力,加快我省与长三角区域互联互通。

13年后的这场会 透露安徽集成电路产业新动向

从无到有

2013年10月10日~11日,一场在合肥举行的集成电路行业会议,成为全国关注的焦点。彼时,在芯片领域,安徽的产业还近乎空白:合肥本地市场芯片年需求对应产值超过200亿元,家电、面板、汽车、装备85%芯片靠进口。少量设计、封测、材料企业,不足以呼应产业发展的需求。

13年后,在4月29日的会议上,安徽与合肥半导体行业协会理事长陈军宁介绍,安徽产业发展增速远超行业预期。截至2025年,全省集成电路产业总产值突破1500亿元,年均复合增速达30%,企业总量突破700家,覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试、EDA、材料与设备全产业链。其中设计企业530家、制造11家、封测52家、配套环节149家。

作为核心承载区,合肥集聚企业超500家,形成龙头企业驱动格局,部分企业位居全球晶圆代工市场前列,显示驱动芯片代工规模全球领先。存储芯片、显示驱动芯片成为安徽标志性集群。省内,滁州、芜湖、蚌埠、马鞍山等城市多点布局,在功率器件、汽车电子、MEMS、特色封测、高纯材料等领域错位深耕。

长三角分工再定位

作为产业后发省份,安徽的集成电路产业结构,也在全国尤其是长三角区域一体化中面临着下一步发展的定位焕新。

相关资料显示,长三角集成电路产值占全国近70%,沪苏浙皖已形成高度协同的产业分工体系。上海强于高端设计、人才与创新生态;江苏封测规模全球领先;浙江聚焦材料、设备与EDA工具;安徽则以晶圆制造为核心长板,制造业产值占比达45%,成为区域产业链稳定运行的“压舱石”。

陈军宁在现场介绍,安徽拥有充足优质的制造产能,但高端芯片设计这条“输水管道”尚不畅通,但安徽也有自己的特点。我省明确承接上海设计成果落地量产、配套江苏封测、联动浙江材料设备的产业定位。合肥三大开发区功能分工持续优化:经开区聚焦存储芯片、高新区发力AI与高端通用芯片设计、新站区深耕特色代工。

AI重构换道超车

2025年大模型、2026年智能体、智能网联汽车等新赛道,以AI为核心,深刻改变全球产业格局,对

科创融

安徽科创资讯权威平台

2013年10月10~11日,在位于合肥市金寨路旁的安徽国际会展中心举行的中国集成电路设计业2013年年会暨合肥集成电路产业创新发展高峰论坛,成为安徽集成电路产业发展的开端。13年后,4月29日,又一场行业重磅会议“智造‘芯’纪元——新一代智能芯片设计创新论坛”,在位于合肥市蜀山区的1986都市科创园举行,安徽、合肥半导体行业协会、合肥市发改委、科大硅谷、安徽大学、合肥人工智能与大数据研究院、弘毅投资等主管部门、协会、创新平台、高校、投资机构,以及来自北京、上海、深圳等主要城市的半导体企业云集,对外释放清晰信号:依托长三角一体化分工、制造端规模优势与AI+EDA技术变革,安徽要从晶圆制造基地,向具备全球竞争力的智能芯片创新高地转型,以差异化路径冲刺世界级集成电路产业集群。



安徽和合肥半导体产业协会理事长陈军宁介绍我省产业发展情况

集成电路行业的技术路线、产业能力提出更高要求。

4月29日会议,上海伴芯科技首次对外介绍其“芯片设计智能体超级工厂”解决方案,并首次公开阐述将AI智能体引入芯片设计全流程的实践,推出实现SPEC-T0-GDS流程100倍效能提升的落地路径。

合肥也成为伴芯科技AI+EDA落地首选地。在伴芯科技创始人兼CEO朱允山看来,合肥拥有中国科大、合工大等顶尖科教资源,龙头企业提供真实工艺参数与量产场景,政策精准、产业链完善,是长三角及全国智能芯片设计技术转化的“优质土壤”。目前,伴芯科技已与安徽本土企业深度对接,推动AI设计能力规模化落地。

激活中小企业

在这次会议上,由弘毅投资与伴芯科技联合打造的ICC芯片设计公共服务平台正式亮相。

弘毅投资是联想控股旗下中国老牌头部PE,成立于2003年。合肥市蜀山区1986都市科创园由该公司与蜀山区科创集团联手更新打造,也成为此次集成电路行业会议的承载地,已引入部分芯片设计企业入驻。

相关负责人介绍,ICC平台面向高端装备AI芯片设计,搭建“设计一流片一测试”全闭环服务体系,整合70余种MPW流片资源,共享头部企业核心工艺参数与市场需求,为中小设计企业提供一站式研发支持,解决企业无流片渠道、无工艺数据、成本高、周期长等痛点。目前,平台已服务近10家企业,引进瑞禾芯成、港宁等优质AI芯片项目。

迈向“双强时代”

13年前,发力开端;13年后,优化结构。安徽集成电路产业的战略发展,从要素驱动转向创新驱动。

陈军宁解读,从行业来看,提升成熟制程与特色工艺,是安徽集成电路产业发展的未来竞争力出路:以AI+EDA加速设计跃升,推动产业从“制造强”走向“制造、设计双强”;深化长三角一体化,推动省内错位协同;强化人才与资本支撑,汇聚全球创新资源。

从“芯屏汽合”到AI芯片生态,安徽集成电路始终紧随新型显示、新能源汽车、人工智能发展大潮,产业增速持续领跑全国。正如朱允山在会议上所言:“与其观望行业潮汐,不如主动主宰产业洋流。”

安徽商报记者 邵征 李娜